

Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards - Part 13: Detail specification for two-part connectors of assessed quality, for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with free connectors for non-accessible insulation displacement terminations (ID)

EESTI STANDARDI EESSÕNA**NATIONAL FOREWORD**

| | |
|--|---|
| <p>Käesolev Eesti standard EVS-EN 60603-13:2002 sisaldab Euroopa standardi EN 60603-13:1998 ingliskeelset teksti.</p> | <p>This Estonian standard EVS-EN 60603-13:2002 consists of the English text of the European standard EN 60603-13:1998.</p> |
| <p>Standard on kinnitatud Eesti Standardikeskuse 18.12.2002 käskkirjaga ja jõustub sellekohase teate avaldamisel EVS Teatajas.</p> | <p>This standard is ratified with the order of Estonian Centre for Standardisation dated 18.12.2002 and is endorsed with the notification published in the official bulletin of the Estonian national standardisation organisation.</p> |
| <p>Standard on kättesaadav Eesti standardiorganisatsioonist.</p> | <p>The standard is available from Estonian standardisation organisation.</p> |

ICS 31.220.10

Standardite reprodutseerimis- ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, palun võtke ühendust Eesti Standardikeskusega:
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee

Right to reproduce and distribute Estonian Standards belongs to the Estonian Centre for Standardisation

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, without permission in writing from Estonian Centre for Standardisation.

If you have any questions about standards copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation:
Aru str 10 Tallinn 10317 Estonia; www.evs.ee; Phone: +372 605 5050; E-mail: info@evs.ee

EUROPEAN STANDARD

EN 60603-13

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

February 1998

ICS 31.220.10

Descriptors: Electronic components, electric connectors, printed-circuit cards, designation, detail specifications, electric properties, dimensions, mechanical properties, conformity tests, quality assurance, quality control, routine verification

English version

**Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards
Part 13: Detail specification for two-part connectors of assessed quality, for
printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with free connectors for
non-accessible insulation displacement terminations (ID)
(IEC 60603-13:1995)**

Connecteurs pour fréquences inférieures
à 3 MHz pour utilisation avec cartes
imprimées

Partie 13: Spécification particulière pour
connecteurs en deux parties, sous
assurance de la qualité pour cartes
imprimées pour grille de base de
2,54 mm (0,1 in), avec fiches pour
bornes de sortie non-accessibles à
déplacement (CAD)
(CEI 60603-13:1995)

Steckverbinder für gedruckte
Schaltungen für Frequenzen unter
3 MHz

Teil 13: Bauartspezifikation für
gütebestätigte indirekte Steckverbinder
für gedruckte Schaltungen mit Raster
2,54 mm (0,1 in), mit freiem
Steckverbinder für
Schneidklemmenanschluß (ID)
(IEC 60603-13:1995)

This European Standard was approved by CENELEC on 1998-01-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

Foreword

The text of the International Standard IEC 60603-13:1995, prepared by SC 48B, Connectors, of IEC TC 48, Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment, was submitted to the formal vote and was approved by CENELEC as EN 60603-13 on 1998-01-01 without any modification.

The following dates were fixed:

- latest date by which the EN has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement (dop) 1998-12-01
- latest date by which the national standards conflicting with the EN have to be withdrawn (dow) 1998-12-01

Annexes designated "normative" are part of the body of the standard.
In this standard, annexes A and ZA are normative.
Annexes ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 60603-13:1995 was approved by CENELEC as a European Standard without any modification.

This document is a preview generated by EVS

Annex ZA (normative)

**Normative references to international publications
with their corresponding European publications**

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

NOTE: When an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

| <u>Publication</u> | <u>Year</u> | <u>Title</u> | <u>EN/HD</u> | <u>Year</u> |
|--|----------------------|--|--------------------------|-------------|
| IEC 60068-1 + corr. October + A1 | 1988 1988 1992 | Environmental testing Part 1: General and guidance | EN 60068-1 | 1994 |
| IEC 60068-2-60 | 1990 ¹⁾ | Part 2: Tests - Test Ke: Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentration of polluting gas(es) | - | - |
| IEC 60097 | 1991 | Grid systems for printed circuits | EN 60097 | 1993 |
| IEC 60352-1 | 1983 | Solderless connections Part 1: Solderless wrapped connections General requirements, test methods and practical guidance | EN 60352-1 ²⁾ | 1994 |
| IEC 60352-4 | 1994 | Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections General requirements, test methods and practical guidance | EN 60352-4 | 1994 |
| IEC 60352-5 | 1995 | Part 5: Solderless press-in connections General requirements, test methods and practical guidance | EN 60352-5 | 1995 |
| IEC 60410 | 1973 | Sampling plans and procedures for inspection by attributes | - | - |
| IEC 60512-1 | 1984 ³⁾ | Electromechanical components for electronic equipment - Basic testing procedures and measuring methods Part 1: General | - | - |
| A1 | 1988 | | - | - |

1) IEC 60068-2-60:1995 is harmonized as EN 60068-2-60:1996.

2) EN 60352-1 is superseded by EN 60352-1:1997, which is based on IEC 60352-1:1997.

3) IEC 60512-1:1994 is harmonized as EN 60512-1:1994.

| <u>Publication</u> | <u>Year</u> | <u>Title</u> | <u>EN/HD</u> | <u>Year</u> |
|--------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| IEC 60512-2 | 1985 | Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests | - | - |
| IEC 60512-3 | 1976 | Part 3: Current-carrying capacity tests | - | - |
| IEC 60512-4 | 1976 | Part 4: Dynamic stress tests | - | - |
| IEC 60512-5 | 1992 | Part 5: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests | - | - |
| IEC 60512-7 | 1993 | Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests | - | - |
| IEC 60512-8 | 1993 | Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts and terminations | - | - |
| IEC 60512-9 | 1992 | Part 9: Miscellaneous tests | - | - |
| IEC 60603-1 | 1991 | Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards Part 1: Generic specification General requirements and guide for the preparation of detail specifications, with assessed quality | - | - |
| + A1 | 1992 | | EN 60603-1 | 1998 |
| IEC QC 001002 | 1986 | Rules of procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ) | - | - |
| A1 | 1992 | | - | - |
| ISO 272 | 1982 | Fasteners Hexagon Products Width across flats | - | - |
| ISO 468 | 1982 | Surface roughness Parameters, their values and general rules for specifying requirements | - | - |

This document is a preview generated by EVS

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
603-13

QC 010000XX0001

Première édition
First edition
1995-01

This document is a preliminary draft and is not to be used for any purpose without the express written consent of IEC.

**Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz
pour utilisation avec cartes imprimées –**

Partie 13:

Spécification particulière pour connecteurs en deux parties sous assurance de la qualité pour cartes imprimées pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in), avec fiches pour bornes de sortie non accessibles à déplacement d'isolant (CAD)

**Connectors for frequencies below 3 MHz
for use with printed boards –**

Part 13:

Detail specification for two-part connectors of assessed quality, for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with free connectors for non-accessible insulation displacement terminations (ID)



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 603-13: 1995

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électro-technique;*
- la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles;*
- la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas;*

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale.*

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology;*
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets;*
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams;*

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice.*

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
603-13

QC 010000XX0001

Première édition
First edition
1995-01

This document is a preliminary draft of a new Geneva-based IEC standard

**Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz
pour utilisation avec cartes imprimées –**

Partie 13:

Spécification particulière pour connecteurs en deux parties sous assurance de la qualité pour cartes imprimées pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in), avec fiches pour bornes de sortie non accessibles à déplacement d'isolant (CAD)

**Connectors for frequencies below 3 MHz
for use with printed boards –**

Part 13:

Detail specification for two-part connectors of assessed quality, for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with non-accessible insulation displacement terminations (ID)

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

X

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

| | Pages |
|---|-------|
| AVANT-PROPOS | 4 |
| Articles | |
| 1 Domaine d'application | 6 |
| 2 Références normatives | 6 |
| 3 Désignation de type CEI | 10 |
| 4 Caractéristiques communes | 12 |
| 4.1 Vue isométrique | 12 |
| 4.2 Description des modèles | 14 |
| 5 Dimensions | 14 |
| 5.1 Généralités | 14 |
| 5.2 Embases | 14 |
| 5.3 Fiches | 26 |
| 5.4 Informations sur le montage des modèles d'embases A et B | 32 |
| 6 Calibres | 36 |
| 7 Caractéristiques | 38 |
| 7.1 Catégorie climatique | 38 |
| 7.2 Caractéristiques électriques | 38 |
| 7.3 Caractéristiques mécaniques | 42 |
| 8 Programme d'essai | 46 |
| 8.1 Généralités | 46 |
| 9 Procédures d'assurance de la qualité | 72 |
| 9.1 Essais d'homologation | 72 |
| 9.2 Contrôle de conformité de la qualité | 74 |
| 9.3 Livraison différée, nouveau contrôle | 78 |
| 10 Informations devant figurer dans les commandes | 78 |
| Annexe A – Phase d'essai BP 3.2: Corrosion, atmosphère industrielle | 80 |

CONTENTS

| | Page |
|---|------|
| FOREWORD | 5 |
| Clause | |
| 1 Scope | 7 |
| 2 Normative references | 7 |
| 3 IEC type designation | 11 |
| 4 Common features | 13 |
| 4.1 Isometric view | 13 |
| 4.2 Survey of styles | 15 |
| 5 Dimensions | 15 |
| 5.1 General | 15 |
| 5.2 Fixed connectors | 15 |
| 5.3 Free connectors | 27 |
| 5.4 Mounting information for fixed connectors, styles A and B | 33 |
| 6 Gauges | 37 |
| 7 Characteristics | 39 |
| 7.1 Climatic category | 39 |
| 7.2 Electrical characteristics | 39 |
| 7.3 Mechanical characteristics | 43 |
| 8 Test schedule | 47 |
| 8.1 General | 47 |
| 9 Quality assessment procedures | 73 |
| 9.1 Qualification approval testing | 73 |
| 9.2 Quality conformance inspection | 75 |
| 9.3 Delayed delivery, re-inspection | 79 |
| 10 Ordering information | 79 |
| Annex A – Test phase BP 3.2: Corrosion, industrial atmosphere | 81 |

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES INFÉRIEURES À 3 MHz POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMÉES -

Partie 13: Spécification particulière pour connecteurs en deux parties sous assurance de la qualité pour cartes imprimées pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in), avec fiches pour bornes de sortie non accessibles à déplacement d'isolant (CAD)

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 603-13 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| DIS | Rapport de vote |
|------------|-----------------|
| 48B(BC)252 | 48B/367/RVD |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spécification dans le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz FOR USE
WITH PRINTED BOARDS -Part 13: Detail specification for two-part connectors of assessed quality,
for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with
free connectors for non-accessible insulation
displacement terminations (ID)

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 603-13 has been prepared by sub-committee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

| | |
|------------|------------------|
| DIS | Report on voting |
| 48B(CO)252 | 48B/367/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annex A forms an integral part of this standard.

CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES INFÉRIEURES À 3 MHz POUR UTILISATION AVEC CARTES IMPRIMÉES -

Partie 13: Spécification particulière pour connecteurs en deux parties sous assurance de la qualité pour cartes imprimées pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in), avec fiches pour bornes de sortie non accessibles à déplacement d'isolant (CAD)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 603 couvre une gamme de connecteurs enfichables (deux parties), dont la disposition des contacts est telle que ces contacts sont distants de 2,54 mm (0,1 in) dans les deux directions. La gamme de connecteurs enfichables (deux parties montées sur carte) comprend une embase fixe (connecteur enfichable) comportant des contacts mâles et une fiche comportant des contacts femelles. Ces connecteurs sont principalement destinés à assurer l'interconnexion entre des cartes imprimées, à l'aide d'une grille de base de 2,54 mm (0,1 in) telle qu'indiquée dans la CEI 97 et d'un câble ruban à fils ronds sur une distance entre axes de 1,27 mm (0,05 in). Les embases sont munies de bornes pour connexions à souder, à insertion ou enroulées. Les fiches sont munies de bornes de sortie à déplacement d'isolant non accessibles (CAD).

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 603. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 603 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 68-1: 1988, *Essais d'environnement - Première partie: Généralités et guide*
Amendement n° 1 (1992)

CEI 68-2-60: 1990, *Essais d'environnement - Partie 2: Essais - Essai Ke: Essais de corrosion en atmosphère artificielle à très basse concentration de gaz polluant(s)*

CEI 97: 1991, *Systèmes de grille pour circuits imprimés*

CEI 352-1: 1983, *Connexions sans soudure - Première partie: Connexions enroulées sans soudure - Règles générales, méthodes d'essai et conseils pratiques*

CEI 352-4: 1994, *Connexions sans soudure - Partie 4: Connexions autodénudantes, non accessibles sans soudure - Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CEI 352-5: 1995, *Connexions sans soudure - Partie 5: Connexions insérées à force sans soudure - Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique*

CONNECTORS FOR FREQUENCIES BELOW 3 MHz FOR USE WITH PRINTED BOARDS –

Part 13: Detail specification for two-part connectors of assessed quality, for printed boards for basic grid of 2,54 mm (0,1 in), with free connectors for non-accessible insulation displacement terminations (ID)

1 Scope

This part of IEC 603 covers a range of two-part connectors with contact arrangements having spacings of 2,54 mm (0,1 in) in both directions. The two-part connector range comprises a fixed (board-mounted) connector containing male contacts and a free connector containing female contacts. They are primarily intended to provide interconnection between printed boards using a basic grid of 2,54 mm (0,1 in) as laid down in IEC 97 and round conductor ribbon cable on 1,27 mm (0,05 in) centreline spacing. The fixed connectors are provided with posts either for solder, press-in or wrapped connections. The free connectors are provided with non-accessible insulation displacement terminations.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 603. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 603 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 68-1: 1988, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*
Amendment No. 1 (1992)

IEC 68-2-60: 1990, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ke: Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentration of polluting gas(es)*

IEC 97: 1991, *Grid systems for printed circuits*

IEC 352-1: 1983, *Solderless connections – Part 1: Solderless wrapped connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 352-4: 1994, *Solderless connections – Part 4: Solderless non-accessible insulation displacement connections – General requirements, test methods and practical guidance*

IEC 352-5: 1995, *Solderless connections – Part 5: Solderless press-in connections – General requirements, test methods and practical guidance*

CEI 410: 1973, *Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs*

CEI 512-1: 1984, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Première partie: Généralités*
Modification n° 1 (1988)

CEI 512-2: 1985, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Deuxième partie: Examen général, essais de continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte diélectrique*

CEI 512-3: 1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Troisième partie: Essais de courant limite*

CEI 512-4: 1976, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Quatrième partie: Essais de contraintes dynamiques*

CEI 512-5: 1992, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 5: Essais d'impact (composants libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais de surcharge*

CEI 512-7: 1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 7: Essais de fonctionnement mécanique et essais d'étanchéité*

CEI 512-8: 1993, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 8: Essais mécaniques des connecteurs, des contacts et des sorties*

CEI 512-9: 1992, *Composants électromécaniques pour équipements électroniques; procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 9: Essais divers*

CEI 603-1: 1991, *Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec cartes imprimées – Partie 1: Spécification générique – Prescriptions générales et guide de rédaction des spécifications particulières, avec assurance de la qualité*
Amendement n° 1 (1992)

CEI QC 001002: 1986, *Règles de procédures de système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ)*
Amendement n° 1 (1992)

ISO 272: 1982, *Éléments de fixation – Produits hexagonaux – Dimension des surplats*

ISO 468: 1982, *Rugosité de surface – Paramètres, leurs valeurs et les règles générales de la détermination des spécifications*

IEC 410: 1973, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

IEC 512-1: 1984, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 1: General*
Amendment No. 1 (1988)

IEC 512-2: 1985, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 2: General examination, electrical continuity and contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests*

IEC 512-3: 1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 3: Current-carrying capacity tests*

IEC 512-4: 1976, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 4: Dynamic stress tests*

IEC 512-5: 1992, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 5: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and overload tests*

IEC 512-7: 1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests*

IEC 512-8: 1993, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical tests on contacts and terminations*

IEC 512-9: 1992, *Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring methods – Part 9: Miscellaneous tests*

IEC 603-1: 1991, *Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards – Part 1: Generic specification – General requirements and guide for the preparation of detail specifications, with assessed quality*
Amendment No. 1 (1992)

IEC QC 001002: 1986, *Rules of procedure of the IEC quality assessment system for electronic components (IECQ)*
Amendment No. 1 (1992)

ISO 272: 1982, *Fastener hexagon products – Width across flats*

ISO 468: 1982, *Surface roughness – Parameters, their values and general rules for specifying requirements*